

インダクタ

積層パワーインダクタ **MLP1608-V** シリーズの開発、量産化

- ・ 2012 形状から小型・低背化し、ラインアップを追加

2012 年 2 月 21 日

TDK 株式会社のグループ会社である TDK-EPC 株式会社（社長：上釜健宏）は、スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラ等のモバイル機器の電源回路用途として、積層パワーインダクタ MLP1608-V シリーズを開発し、2012 年 2 月より量産を開始します。

本製品は、当社独自の材料技術によって開発した、コアロスを低減させた低損失フェライトを磁性材料として採用しております。また、従来品シリーズの 2.5×2.0、2.0×1.6、2.0×1.2 に 1.6×0.8 (mm) 形状の最小サイズを追加することによって、電源回路の小型化により一層貢献します。

電源回路でパワーインダクタとして採用した場合、従来品の MLP2012S (1μH) と比較し容積比 50%以下ですが、100mA 以下での電力変換効率は同等の特性を実現しています。今回の新しい形状は 1608 サイズで、高さ（厚み）は 0.75mm (Max) と 0.95mm (Max) の 2 種類用意しました。

近年のモバイル機器は、多機能化とゲームやカメラなど連続使用、大負荷での利用機会が増大しており、電池の持続性が大きな懸念事項となっております。電圧を変換する電源回路の効率向上は、電力の消費量の低減に直接結びつき、モバイル機器の市場要求に応えることのできる製品です。

用語集

- ・ パワーインダクタ：直流電圧を変換する DC-DC コンバータなどの電源回路で、ノイズ抑制や整流、平滑のために使用するインダクタ。

主な用途

- ・ スマートフォン、携帯電話、デジタルカメラ等、モバイル機器の電源のパワーコイル

主な特長

- ・ 2012 シリーズと比較し、容積比 50%以下で電力変換効率は同等
- ・ 低抵抗で高い定格電流値で幅広い用途に対応

主な特性

製品厚み	製品名	インダクタンス [uH]	直流抵抗 [ohm]	定格電流 [mA]
0.75mm (Max)	MLP1608VR47D	0.47 +/-20%	0.22 +/-30%	800
	MLP1608V1R0D	1.0 +/-20%	0.30 +/-30%	700
0.95mm (Max)	MLP1608VR47B	0.47 +/-20%	0.20 +/-30%	800
	MLP1608V1R0B	1.0 +/-20%	0.30 +/-30%	700
	MLP1608V2R2B	2.2 +/-20%	0.36 +/-30%	600

生産・販売計画

- ・ サンプル価格：15 円／個
- ・ 生産拠点：秋田地区
- ・ 生産予定：1,000 万個／月（当初）
- ・ 生産開始：2012 年 2 月

TDK-EPC 株式会社について

TDK-EPC 株式会社（本社：東京）は TDK のグループ会社であり、TDK の基幹事業である電子部品部門と、ドイツの EPCOS 社との統合で設立された電子部品の開発・製造・販売を担うリーディングカンパニーです。日本を始め、アジア、欧州、米国の各地域に事業の拠点があり、製品ブランドとして TDK および EPCOS 双方の製品を扱います。

主な営業品目は、コンデンサ（積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ）、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等であり、これらの幅広い製品群により、TDK-EPC は情報家電、通信機器、産業機器、車載機器等、世界のあらゆる市場ニーズにお応えします。

本文および関連する画像は http://www.tdk.co.jp/news_center/press/aah86400.htm からダウンロードできます。

報道関係者の問い合わせ先

地域	担当者	所属	電話番号	Email Address
日本	大須賀	TDK 株式会社 広報部	+81 3 5201-7102	pr@jp.tdk.com